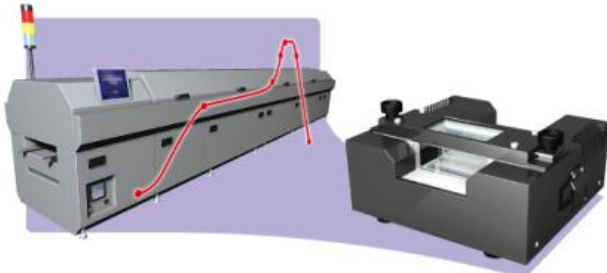
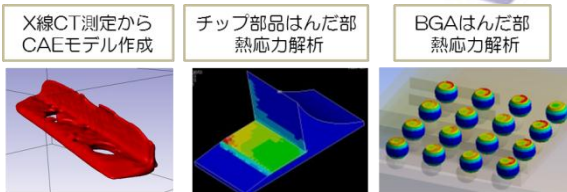


# 電子デバイス・実装技術セミナーのご案内

はんだ実装プロセスの可視化、検査技術の最新動向  
～リフローシミュレータ、基板平坦度測定の実験、デモ～



近年、電子デバイスの微小化が進み、製造・品質管理はますます困難になっています。そこで、「実装プロセスの可視化、検査技術」をテーマとする第1回研究会を、下記により開催いたします。ふるってご参加ください。



- 1 日 時 平成26年8月1日(金) 13:30～16:00
- 2 場 所 福島県ハイテクプラザ 3階 会議室(郡山市待池台1-12)
- 3 内 容、講 師  
 (1)演題:「はんだ実装プロセスの可視化、検査技術の最新動向」  
 講師:株式会社 コアーズ 羽田 拓民 様  
 (2)展示、測定デモ「リフローシミュレータ」  
 (3)演題:「ハイテクプラザにおける電子デバイス、実装技術に関する取り組み」
- 4 受 講 料 無料
- 5 申 込 先 工業材料科 工藤 まで  
 電話 024-959-1737 e-mail : kudo\_hiroyuki\_01@pref.fukushima.lg.jp

※ FAXの場合は、下記の必要事項をご記入の上、御送信下さい。E-mailでの申込みは、各項目を記入の上、タイトルを「セミナー申込」として、御送信下さい。

※ リフローシミュレータについて、自社製品の測定を御希望の方はセミナー申込みに併せて、御希望の内容をお伝えください。全ての要望にはお応えできない可能性もありますので、予めご了承ください。

- 6 申込締切 平成26年7月31日(木)

第1回研究会申込書 FAX 024-959-1761 工業材料科 工藤

企業(団体)名	
所在地	
電話/FAX	
e-mail	
(ふりがな) ご氏名	